

111學年度進修部電子工程系-封裝測試產業精英專班 二技課程規劃表

第一學年(111)						第二學年(112)						
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期		
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數	
校必修						校必修						
	小計						小計					
院必修						院必修						
	小計						小計					
通識教育						通識教育						
	小計						小計					
系專業必修	※封裝能力鑑定(一)	3	3			系專業必修	※測試能力鑑定(一)	3	3			
	※Tester設備操作與維修概論	3	3				※BIB治具設備操作與維修概論	3	3			
	※Handler設備操作與維修概論	3	3				※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3			
	※HF設備操作與維修概論	3	3				※Lead Scanner原理與應用	3	3			
	※積體電路工程	3	3				※半導體製程實務	3	3			
	※半導體元件	3	3				※實務專題(一)	3	3			
	※半導體製程技術			3	3		※半導體產業分析			3	3	
	※積體電路可靠性工程			3	3		※實務專題(二)			3	3	
	※Oven設備操作與維修概論			3	3		※捲帶機原理與應用			3	3	
	※LD/UI設備操作與維修概論			3	3		※打線機原理與應用			3	3	
	※治具設備操作與維修概論			3	3		※黏晶機設備操作與維修概論			3	3	
	※封裝能力鑑定(二)			3	3		※測試能力鑑定(二)			3	3	
	小計	18	18	18	18		小計					
系專業選修						系專業選修						

注意事項：

1. 畢業應修學分爲72學分；含必修：__72__學分，選修：____學分(本系專業選修至少__學分以上)。
2. 表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。

明新科技大學電子系
課程教學小組

電子工程系
主任 楊信佳

半導體學院
2022/3/10 呂明峰